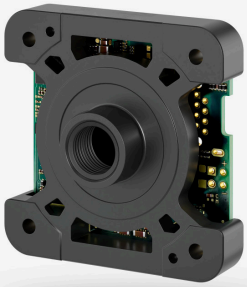
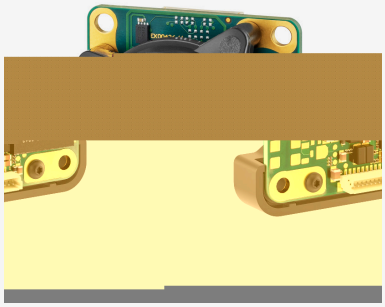
GV-53D1LE-M-MB Rev.2 (1011705)

En serie
El modelo se está produciendo en serie y, por tanto, su disponibilidad a largo plazo está garantizada.



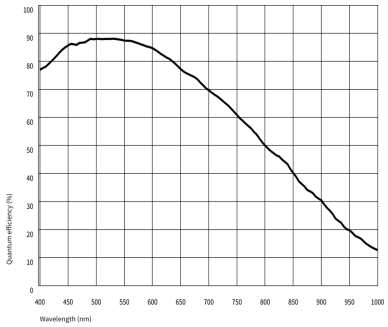




Especificación

Sensor

Tipo de sensor	CMOS Mono
Sistema de obturador	Global Shutter
Characteristic	Lineal
Clase de píxeles	3 MP
Resolución	3,20 Mpx
Resolución (h x v)	2064 x 1552 Pixel
Relación de aspecto	4:3
CAD	12 bit
Profundidad de color (camára)	12 bit
Clase de sensor óptico	1/3,1"
Superficie optica	4,644 mm x 3,492 mm
Diagonal del sensor óptico	5,81 mm 1/3,1"
Tamaño de píxel	2,25 µm
CRA (Chief Ray Angle)	8 °
Fabricante	Sony
Denominación del sensor	IMX900-AMR-C
Ganancia (total/RGB)	16x/-
AOI horizontal	misma frecuencia de imagen
AOI vertical	mayor frecuencia de imagen
AOI ancho de imagen / ancho de paso	256 / 2
AOI alto de imagen / ancho de paso	1 / 1
AOI cuadrícula de posición (horizontal/vertical)	2 / 1
Binning horizontal	mayor frecuencia de imagen
Binning vertical	mayor frecuencia de imagen
Método binning	Horizontal: Promedio / Vertical: Promedio
Factor binning	2x2
Decimation (subsampling) horizontal	-
Decimation (subsampling) vertical	-
Método Decimation (subsampling)	M/C automático



IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Alemania · Tel +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com

GV-53D1LE-M-MB Rev.2 (1011705)

Modelo

Frecuencia de imagen en modo libre	39 fps
Frecuencia de imágenes disparador (continúa)	39 fps
Frecuencia de imágenes disparador (máxima)	50 fps
Tiempo de exposición (mínimo - máximo)	0,023 ms - 2000 ms
Consumo de potencia	2 W - 3,4 W
Memoria gráfica	128 MB

HDR

Modo	QuadHDR

Condiciones ambientales

Para versiones de placa tenga en cuenta las indicaciones específicas que figuran en la documentación pertinente.

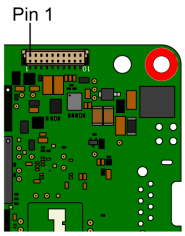
Temperatura del aparato permitida durante el funcionamiento	0 °C - 80 °C / 32 °F - 176 °F
Temperatura ambiente admisible durante el funcionamiento	0 °C - 25 °C / 32 °F - 77 °F
Temperatura ambiente admisible durante el almacenamiento	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
Humedad (relativa, sin condensación)	20 % - 80 %

Conexiones

Conexión de interfaz	ZIF
Conexión I/O	Conector Wuerth de 10 polos (WR-WTB 1.00 mm)
Alimentación	12 V - 24 V

Asignación de pins conexión I/O

1	Tensión de alimentación (VCC) 12-24 V
2	Fuente de alimentación, masa
3	General Purpose I/O (GPIO) 2, 3,3 V - Line 3
4	General Purpose I/O (GPIO) 1, 3,3 V - Line 2
5	I2C SCL (Signal Clock) 3,3 V
6	I2C SDA (Signal Data) 3,3 V
7	Entrada de disparador sin optoacoplador 3,3 V - Line 0
8	Salida de flash sin optoacoplador 3,3 V - Line 1
9	Masa (GND)
10	Salida de tensión 3,3 V, máx. 100 mA



Diseño

Conexión del objetivo	S-Mount
Grado de protección IP	-
Dimensiones	50,0 mm x 50,0 mm x 23,5 mm
Peso	27 g
Material de la carcasa	-

Features

Lista de funciones de preprocesamiento de imágenes integradas en la cámara.
Todas las funciones de la tabla están disponibles a través de nuestro software IDS peak para el preprocesamiento de imágenes en el ordenador host (según el modelo de sensor).

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Alemania · Tel +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com

GV-53D1LE-M-MB Rev.2 (1011705)

Adquisición de imágenes	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	-
	Denoiser	✓
	Long exposure	-
	Line scan	-
Flash	Flashing	✓
	PWM flashing	-
Ajustes de imagen	Auto exposure	✓
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
	Mirror/flip	X/Y
Procesamiento de imágenes integrado	Pixel formats	Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	-
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.
Otros	IP settings	✓
	Bandwidth management	✓
	Chunks	-
	Sequencer	-
	PTP	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.62.25422

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Alemania · Tel +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com